

국내 AI반도체기업 해외진출지원을 위한 COMPUTEX TAIPEI 2025 행사 연계 수출상담회 운영 및 행사참가지원 출장결과보고

(AI반도체팀, 043-931-5831)

□ 추진배경

- AI기술의 급성장과 전 산업 AI확산에 따른 대규모의 연산량을 처리할 수 있는 있는 핵심 인프라로 저전력·고성능의 AI반도체 중요도 급부상, 거대한 글로벌 시장을 형성

* 시스템반도체의 차세대 성장동력인 AI반도체 시장규모는 2022년 411억 달러에서 2028년 1,330억 달러로 연평균 21.6% 성장할 전망

- 이에, 우리 AI반도체 기업의 글로벌 경쟁력 강화와 동남아 등 해외 시장 확장을 위해, 초기 단계의 국내 팹리스 기업 해외 진출 지원 필요

□ 출장목적

- 국내 AI반도체 기업의 글로벌 수요처/파트너 발굴, 현지 시장정보와 네트워크 확보를 위한 수출상담회 운영 및 국제 행사(COMPUTEX) 참가 지원

〈AI반도체 해외진출지원 행사 개요〉

- 행사명 : AI반도체 수출상담회 및 COMPUTEX 2025참관 지원(NIPA 운영)
- 일시/장소 : 2025. 5. 20.(수) ~ 5. 23.(금) / 대만 Taipei Nangang Exhibition Center 및 TCA(Taiwan Computer Association) 회의실
 - Computex 2025 참관 및 현지 네트워킹 지원 : 5.20, 5.23
 - 현지 수요처/파트너 연계를 위한 AI반도체 수출상담회 : 5.21~5.22
- "Taiwan-Korea AI Semiconductor Business Partnership"
- 참가규모 : 국내 AI반도체 기업 6개사
(딥엑스, 망고부스트코리아, 모빌린트, 유엑스팩토리, 텔레칩스, 퓨리오사AI)
- 주요 내용
 - COMPUTEX TAIPEI 행사 참관 및 네트워킹 지원
 - AI반도체 대만 수출상담회 개최

대만 COMPUTEX 2025 행사 개요

○ 행사명 : COMPUTEX TAIPEI 2025

* 중화민국대외무역발전협회(TAITRA), 타이페이컴퓨터협회(TCA) 공동주최

○ 일시/장소 : 2025. 5. 20.(화) ~ 5. 23.(금) / 대만 Taipei Nangang Exhibition Center

○ 참가규모 : 참가기업 1,400개, 4,800개 부스, 참관객 40,000여명 등

*ASUS, Acer, MSI, GIGABYTE, BenQ, MediaTek, ASRock, Vertiv Taiwan, G.SKILL, KIOXIA Taiwan, Foxconn, Pegatron, Pro Gamersware, QCT, Auras, Intel, Realtek, Advantech, ADATA, ITRI(Industrial Technology Research Institute), Delta, Inventec, LITEON, MiTAC, Transcend, Silicon Power, Innodisk, Wistron 등 글로벌IT기업 참가

○ 전시카테고리 : AI & Robotics, Next-Gen Tech, Future Mobility (메인테마 AI Next)

- 국산 AI반도체 활성화 정책지원을 위한 글로벌 트렌드 및 시장현황 파악, 주요 기업/유관기관 협력 네트워크 확보

□ 출장개요

출장자	출장기간	출장국가 (방문도시)	예산(원)
정재학 팀장 이병목 수석	5.19(화) ~ 5.23(금) (4박 5일)	대만 (타이베이)	5,134,348

□ 주요 활동 내역

- 우리 AI반도체 기업 수출상담회 행사 운영 지원
 - 국내 AI반도체 기업 수출상담회장 운영
 - 국내 기업 수출상담회 성과 발굴
 - 국내 참여기업 수출상담회 성과(바이어 구매 의향, 투자 의향 등)
 - 대만 현지 수요 업체와의 네트워킹 기회 제공
- 우리 AI반도체 기업 COMPUTEX TAIPEI 행사 참관 지원
 - 국내 AI반도체 기업 행사참관 지원
 - 우리 기업과 글로벌IT기업 네트워킹 지원
- AI반도체 시장 정보 수집 및 협력 네트워크 확보
 - COMPUTEX 행사참가, 현지 AI, AI반도체 현황 및 주요 수요처 정보 확보, 관련 기업 및 유관 기관 협력 네트워크 확보

□ 출장자별 역할분담

출장자	세부 역할
정재학 팀장	<ul style="list-style-type: none"> ○ AI반도체 수출상담회 및 행사 참가 지원 총괄 ○ 현지 수요처 발굴 및 우리 기업 네트워킹 지원 ○ 시장조사, 현지 협단체 등 AI반도체 진출 위한 협력 네트워크 확보
이병묵 수석	<ul style="list-style-type: none"> ○ AI반도체 수출상담회장 사전 점검 및 운영 지원 ○ AI반도체 수출상담회 성과 관리 ○ 시장조사, 현지 협단체 등 AI반도체 진출 위한 협력 네트워크 확보 ○ COMPUTEX행사 참관 및 글로벌IT기업 네트워킹 지원

□ 세부일정

- 정재학 팀장 : 기업지원 총괄
- 이병묵 수석 : 행사진행 및 현장지원

일 정		방문지역	내용
1일차	5.19(월)	인천-타이베이(TPE)	<ul style="list-style-type: none"> • 인천출발 14:20 → 타이페이 도착15:50 • 기업 사전 미팅 및 계획 협의
2일차	5.20(화)	타이베이(TPE)	<ul style="list-style-type: none"> • COMPUTEX 2025 행사 참관 지원 • 우리기업-글로벌IT기업 네트워킹 지원
3일차	5.21(수)	타이베이(TPE)	<ul style="list-style-type: none"> • AI반도체 수출상담회 운영 지원 • 제품 홍보 운영 및 비즈니스 미팅지원
4일차	5.22(목)	타이베이(TPE)	<ul style="list-style-type: none"> • AI반도체 수출상담회 운영 지원 • 제품 홍보 운영 및 비즈니스 미팅지원
5일차	5.23(금)	타이베이(UAE)	<ul style="list-style-type: none"> • 시장정보수집, 협력네트워크 미팅 • 타이페이출발 17:10 → 인천 도착 20:40

붙임 1

2025 1차 AI반도체 수출상담회 지원결과(대만)

□ 2025년 1차 AI반도체 수출상담회 행사 개요

2025년 1차 AI반도체 수출상담회 행사 개요

- (행 사 명) 2025년 1차 AI반도체 대만 수출상담회
(2025 Taiwan-Korea AI Semiconductor Business Partnership)
- (기 간) 2025년 5월 19일(월) ~ 5월 23일(금) 5일간
- (장 소) 대만(타이베이) TCA 내 회의실, COMPUTEX 전시장
- (파견기업) 덩엑스, 망고부스트코리아, 모빌린트, 유엑스팩토리,
텔레칩스, 퓨리오사AI (AI반도체 기업 6개사 참가)
- (행사구성) 전시회 참가 / B2B 상담회 / 기관 네트워킹 /
기업발표 등
- (주최/주관) 과학기술정보통신부, NIPA
- (목적)
 - AI반도체 팹리스 분야 중소·중견기업의 해외 시장진출 및 파트
너십 구축
 - AI, ICT 기술 교류와 비즈니스 네트워킹 활성화

□ 국내 AI반도체 수출상담회 지원 결과

○ AI반도체사 성과 총괄표

국내기업	제품/서비스	상담 (건)	상담규모 (USD)	MOU/NDA (건)
딥엑스	신경망처리장치(DX-M1, DX-H1)	5	15,000	
망고부스트	망고부스트 DPU	5	22,000	MOU 1 NDA 1
모빌린트	MLA100 (엣지용 NPU 내장 PCIe Card), MLX-A1 (독립형 AI Box), REGULUS (독립형 AI 시스템 온칩)	15	82,000	
유엑스팩토리	온 센서 AI SoC 칩	9	7,493,600	
텔레칩스	TOPST D3-G, TOPST AI-G, TOPST VCP-G	10	300,000	
퓨리오사AI	RNGD	9	803,000	
합계		48	8,715,600	2

□ 참가 개요

○ (참가 인원) NIPA AI 반도체 팀, AI 반도체 기업 6개사

번호	구분	기업/기관명	출장자(직위)	직함
1	기관	NIPA	정재학	팀장
2	기관	NIPA	이병목	수석
3	참가기업	딥엑스	차민경	매니저
4	참가기업	망고부스트코리아	이원식	팀장
5	참가기업	모빌린트	김성모	상무
6	참가기업	모빌린트	김준엽	선임
7	참가기업	모빌린트	장위철	선임
8	참가기업	유엑스팩토리	박준영	대표
9	참가기업	텔레칩스	모우진	팀장
10	참가기업	텔레칩스	신찬휴	매니저
11	참가기업	퓨리오사AI	김진수	이사

○ (참가기업정보)

1	딥엑스	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 설립된 차세대 AI NPU(Near Processing Unit) 개발 전문 기업 ○ 주요 제품: NPU 'DX-GEN1', 초저전력 AI 연산 프로세서 ○ 스마트팩토리, 헬스케어, IoT 기기 등 엣지 AI 분야에서 기술 확장
2	망고부스트	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 설립된 데이터처리가속기(DPU) 및 AI 추론 최적화 솔루션 개발 전문 기업 ○ 주요 제품: DPU 'MBDPU-1', AI 추론 최적화 소프트웨어 'Mango LLMBoost' ○ 데이터센터, AI 추론, 대규모 언어 모델(LLM) 등 고성능 컴퓨팅 분야에서 기술 확장
3	모빌린트	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 설립된 AI 반도체 및 온디바이스(On-Device) AI 솔루션 기업 ○ 주요 제품: 고성능 AI 칩셋 (예: Mobilint AI-Chip Series) ○ 제조업, 헬스케어, 공공 분야에서 AI 반도체 기술 적용
4	유엑스팩토리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사용자 경험(UX) 및 사용자 인터페이스(UI) 디자인 전문 기업 ○ 주요 제품: 온 센서 AI SoC칩 ○ 웹, 모바일, IoT 등 다양한 플랫폼에서 사용자 중심의 디자인 솔루션 제공
5	텔레칩스	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1999년 설립된 차량용 및 스마트홈용 팹리스 반도체 설계 전문 기업 ○ 주요 제품: TOPST D3-G, TOPST AI-G, TOPST VCP-G ○ 자동차 전장, 스마트홈 등 분야에서 글로벌 시장 점유율 확대
6	퓨리오사AI	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017년 설립된 AI 반도체 설계 전문 팹리스 기업 ○ 주요 제품: AI 추론 연산 특화 반도체 '워보이(Warboy)', 차세대 AI 칩 '레니게이드(Renegade)' ○ 데이터센터, 생성형 AI 등 고성능 AI 컴퓨팅 분야에서 기술 확장

□ 국내 SI반도체 기업 행사 사진

○ 전시회 부스 참관 및 부스 미팅

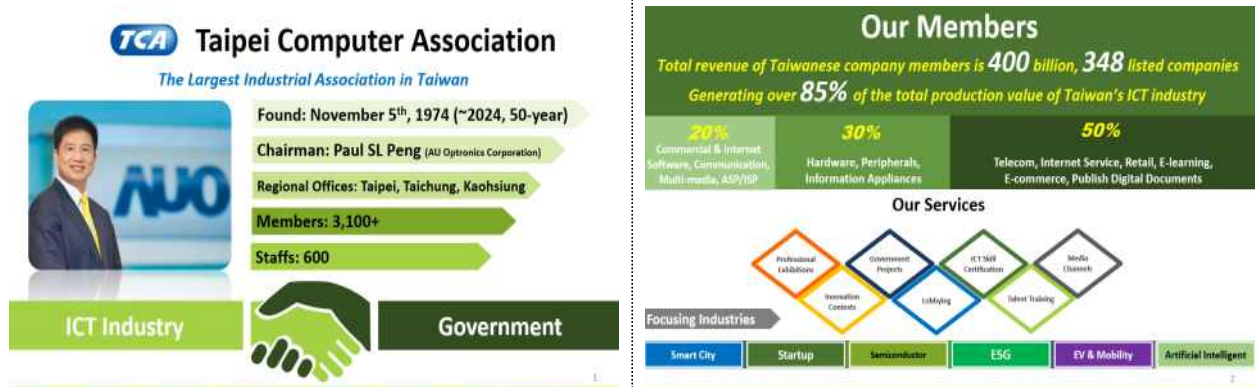


○ 수출상담회 진행



○ 기관 네트워킹

- (기관명) TCA(Taiwan Computer Association)
- (개요) TAITRA와 COMPUTEX 전시회 공동 주관사인 TCA는 1974년에 설립되어 50년 이상 ICT 산업을 촉진해온 정부기관이며 약 3,100개의 회원사 보유



○ Taiwan-Korea AI Tech Networking 한국기업 발표

-(일시) 2025년 5월 21일(수) 오전 10시 ~ 10시 30분

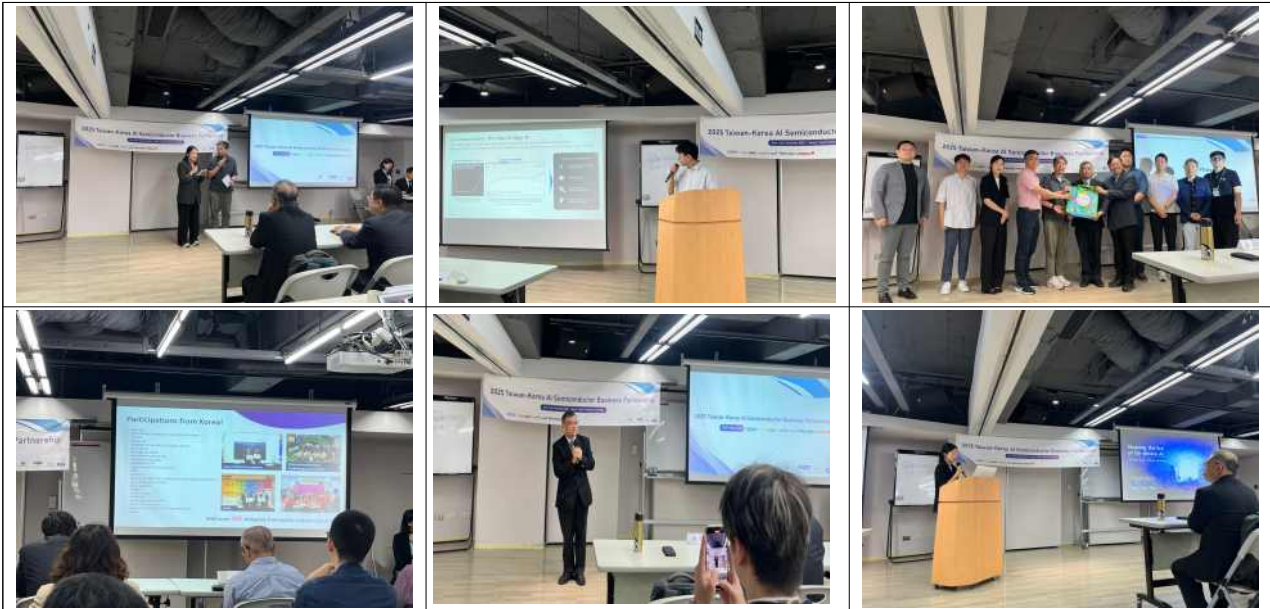
-(장소) TCA(Taiwan Computer Association) 내 B101, B102 회의실

-(발표 주제)

· 모빌린트 : 한국 AI반도체 시장동향 및 모빌린트 소개 (김준엽 선임)

· 딥엑스 : 한국 AI반도체 시장동향 및 딥엑스 소개 (차민정 매니저)





o 바이어 부스 방문 미팅

- (기업명) ASRock
- (개요) 2002년에 설립된 대만의 IT하드웨어 제조사로, 메인보드, 산업용 PC, 그래픽카드 등을 주력으로 생산하고 있음. 본사는 타이베이에 위치하며, 전 세계 시장을 대상으로 제품을 공급하고 있음.

ASRock



□ 참가 바이어 목록

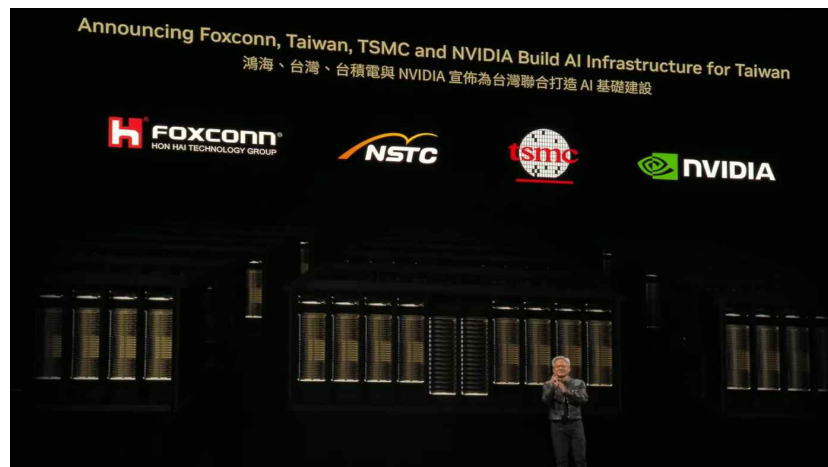
No.	대만 바이어사	담당자 명	담당자 직급
1	eLAND Information. Co., Ltd.	Claire Chi	Marketing Manager
2	Nices Technology	Felicia	Project Manager
3	Aplex Technology	Riven Chao	Vice President
4	Texture Maker	Paul Shih	CEO
5	Skymizer Taiwan Inc.	CL Chen	Senior Vice President
6	Egis Technology Inc.	Todd Lin	Director
7	Clock Computer corp.	Liz Huang	Product Marketing Director
8	Lumi Good CO., LTD.	JC Chu	Director
9	Taipei Computer Association	David Chen	Manager
10	AAEON	Seven Fan	VP
11	Allring	Samuel Liu	Director
12	aetina	Ethan Chan	Senior Manager
13	AUO Display	Corey Lee	R&D Manager
14	JRK Vision	Kevin Weng	Sales
15	Lanner	Tom Lee	PM
16	SYMHOPE Co.	Hunt Hung	CEO
17	Yuan	Stephan Chuang	PM Director
18	ALLNET	David Yu	-
19	LEX System	박태웅	이사
20	INFINIX	Shing Ko	Sales Director
21	Morale AI	-	-
22	TWS	Peter Yu	General Manager
23	Semidynamics	Roger Espasa	-
24	ASRock	Justin Kuo	-
25	Super Micro Computer, Inc.	Howard Hsu	Director, Product Management
26	Giga Computing Technology, Inc.	Freya Yu	Director, Sales Division III
27	Edgecore Networks	Charles Chen	Sr. Director, APAC Sales Div.
28	AIC Inc	David Huang	VP, Product Sales Marketing Division
29	Ufi Space Co., Ltd	David Hsieh	VP, Business Dev. & Chief Digital Officer

1. COMPUTEX 2025 AI반도체 트렌드

① NVIDIA의 AI인프라 기업으로의 전환 : Intelligence Infrastructure

- (얼라이언스) NVIDIA는 기조연설을 통해 AI 데이터센터를 넘어선 AI 팩토리 구축을 위한 인프라 전략으로 다양한 OEM 기업들과의 협력을 통한 네트워크, 서버, 전력 등에 대한 기술을 발표

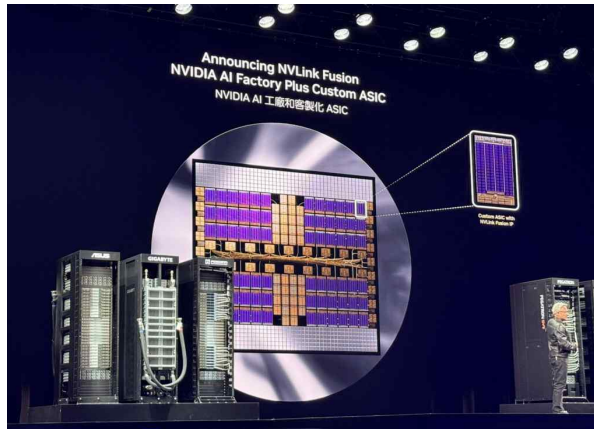
<NVIDIA가 이끄는 대만 AI인프라 생태계>



* 자료 : ('25.05) 패스트캠퍼스 미디어

- (네트워크) NVIDIA는 자사 반도체뿐 아니라 서로 다른 AI반도체를 초고속으로 연결하여 다양한 구성의 AI인프라를 구축할 수 있는 NVLink Fusion을 기조연설을 통해 발표
 - MediaTek, Marvell, Synopsys, Cadence 등은 NVLink Fusion을 최초로 채택하여 모델 훈련 및 Agentic AI 추론 요구사항 충족
 - Qualcomm은 자사 CPU를 NVIDIA의 GPU와 통합하여 고성능의 AI 팩토리를 구축함으로써 AI 데이터센터 시장 진입 계획

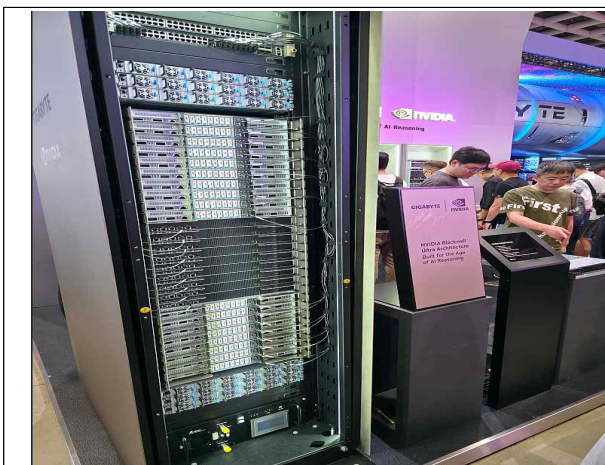
<COMPUTEX 2025 NVIDIA 기초연설>



* 자료 : ('25.05) NVLink Fusion: Nvidia Unveils Supercharging AI with Qualcomm, Fujitsu, and MediaTek Collaboration, techovedas

- (서버) NVIDIA는 대만의 서버 벤더사인 GIGABYTE, Foxconn 등과 협력하여 고성능의 AI 추론을 효과적으로 사용할 수 있는 서버를 공개
 - GIGABYTE와 Foxconn은 72개의 Blackwell Ultra GPU 72개와 36개의 NVIDIA Grace CPU를 랙 스케일로 연결한 NVIDIA GB300 NVL72 플랫폼을 지원하는 서버 전시
 - * GB300 NVL72 플랫폼은 대규모의 AI 추론에 활용되며, 액체냉각 솔루션을 포함
 - Foxconn은 NVIDIA와 협력하여 대만 내 100MW급 규모의 AI 데이터센터 구축 계획

<NVIDIA GB300 NVL72 서버>



<GIGABYTE GB300 NVL72 서버>



<Foxconn GB300 NVL72 서버>

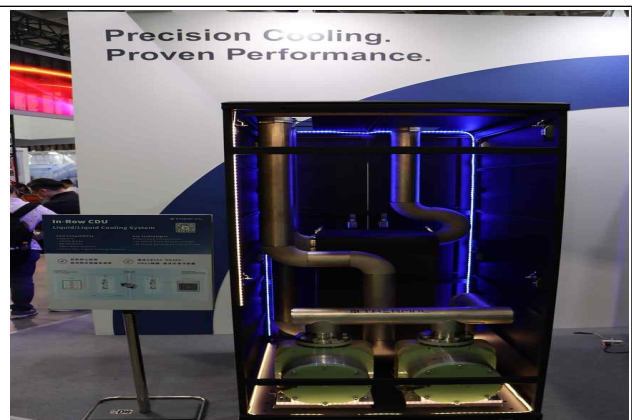
* 자료 : ('25.05) [컴퓨텍스 2025] 리퀴드쿨링, AI서버 인프라 '새 표준', kharn

- (전력/냉각) 데이터센터의 AI 처리로 인한 높은 전력 소모와 발열 문제 해결을 위한 디지털 트윈 기술 활용 및 액체냉각 방식에 초점
 - Schneider Electric은 NVIDIA와 협력하여 NVIDIA Omniverse와 통합된 디지털 트윈 기반 전력시뮬레이션 플랫폼 공개
 - * 전력 부하 시뮬레이션, 위험 예측, 냉각 효율성 분석 등을 수행
 - Foxconn, KAORI 등은 NVIDIA GB300 NVL72 플랫폼 지원 서버에 최적화된 액체냉각 솔루션을 공개
 - * Foxconn은 ZutaCore와의 협력을 통해 2상 Direct Liquid Cooling 기술 적용 랙 통합 솔루션 공개

<데이터센터 전력관리 및 냉각 솔루션>



<Schneider Electric 데이터센터 솔루션>



<KAORI 액체냉각 솔루션>

* 자료 : ('25.05) [컴퓨텍스 2025] 리퀴드쿨링, AI서버 인프라 '새 표준', kharn

<NVIDIA의 AI인프라 구축 방향>

GIGABYTE, msi 등 대만 기업 대상 레퍼런스 제공 및 AI인프라 구성요소별 구축을 위한 협력 추진



② 산업특화 Edge AI 솔루션의 부상 : AI반도체의 산업 적용 본격화

- (헬스케어) 수술, 간호, 병원 관리 등 병원에서 사용 가능한 영역을 비롯하여 병원 외에서의 개인 건강 분석 등 다양한 AI 솔루션 공개
 - ADVANTECH는 엣지 컴퓨팅을 활용한 수술, 간호 등의 영역에 대한 AI 솔루션을 공개
 - ASUS는 생성형 AI를 활용한 스마트 헬스케어 솔루션인 헬스케어 4.0을 통해 개인 데이터 분석, AI 이미징 지원, 이상 감지 기술 등을 공개
 - Ainos는 딥러닝을 통한 학습으로 냄새를 디지털화하여 후각 ID로 변환하는 AI Nose 플랫폼을 발표
 - YUAN은 NVIDIA Jetson Orin NX를 활용하여 의료 영상의 AI 처리, 실시간 조직 이상 감시 등 스마트 헬스케어 솔루션 공개

<헬스케어 분야 AI 솔루션>

		
<p><ADVANTECH 헬스케어 솔루션></p>	<p><ASUS 헬스케어 솔루션></p>	<p><YUAN 헬스케어 솔루션></p>

- (모빌리티) 자율주행을 지원하기 위해 통신을 위한 텔레매틱스, 데이터 교환을 위한 게이트웨이, ADAS 등이 공개
 - GIGABYTE는 차량용 통신장비 TCU 기반의 텔레매틱스를 통한 인포테인먼트 기술 및 ADAS 관련 제품을 공개
 - MSI는 딥엑스의 ‘DX-M1+M.2 모듈’을 탑재하여 AI 비전을 활용한 스마트 주차 솔루션 제공

- Inventec은 자율주행 차량에서 이종 네트워크 간의 데이터 교환 및 보안을 이루어지도록 하는 gateway 공개
- MediaTek는 최초로 3nm 공정을 활용한 Automotive Cockpit 플랫폼 SoC인 C-X1을 통해 LLM의 차량 내 운영 가속화

<모빌리티 분야 AI 솔루션>



<GIGABYTE 자율주행 시스템>



<MSI 스마트 주차>



<Inventec gateway>



<MediaTek C-X1>

- (제조) 엣지 AI 및 Agentic AI 기술을 활용하여 공장 내 이상 감지, 공급망 관리, 실시간 모니터링, 오류 수정 등을 수행하여 스마트 팩토리 구축 활성화
- ADVANTECH는 Agentic AI 기술을 활용하여 장비 문제 감지부터 공장 환경 관리, 공급망 관리, 위험 감지 등 스마트 팩토리 구축을 위해 필요한 솔루션을 제공
- Lanner는 스마트 제조를 위한 솔루션으로 Edge AI 워크스테이션,

NVIDIA RTX6000 GPU 등을 활용한 로봇 팔, Autonomous Mobile Robot, 엣지 AI 시스템을 탑재하여 산업 자동화의 정밀도, 처리량 및 유연성을 향상시키는 품질 검사 기능을 제공

<제조 분야 AI 솔루션>



<ADVANTECH 스마트 제조 솔루션>



<Lanner 스마트 제조 시스템>

* 자료 : Lanner 홈페이지

③ AI반도체의 다품종 소량화 추세 : 다양한 칩셋과 다양한 폼팩터

○ (칩셋 다각화) Intel은 AI 기능을 수행할 수 있는 다양한 칩셋을 개발하여 데이터센터, 개인용 PC 등 다양한 제품에 활용, 시장 경쟁력 확보 노력

- 랩탑용 CPU : 인텔의 기존 Arrow Lake CPU 외 노트북 등 PC 내 1.8nm 공정으로 제작된 최초의 칩셋인 Panther Lake 프로세서를 공개하였고, 해당 프로세서는 인텔의 P-core, E-core와 함께 NPU도 탑재되어 대용량 데이터 처리에 적합

* '25년 하반기 대량 생산 예정 및 '26년 프로세서를 탑재한 제품 공개 예정

- 서버용 CPU : 인텔은 머신러닝과 작은 규모의 생성형 AI 개발에 적합한 CPU로 딥러닝, 자연어 처리 등 AI 워크로드에 적합한 내장형 가속기 AMX를 통합한 Intel Xeon 6 프로세서 공개

* 높은 메모리 용량과 대역폭 제공 및 딥러닝 교육·추론 성능 제고, 자연어 처리와 추천 시스템, 이미지 인식 등에 적합

- NPU : AI 학습 및 추론 등의 기능 수행에 대해 가우디3 AI 프로

세서를 출시하여 데이터센터 또는 클라우드에서 대형 언어 모델, 다중 모달 모델, 기업 RAG와 같은 AI 애플리케이션 지원

- GPU : AI 시대가 다가오면서 고효율·저비용으로 AI 추론, 비디오 처리, 고부하 작업 처리를 지원할 수 있는 GPU인 Arc Pro B60과 B50 공개

<AI컴퓨팅 용도로 활용 가능한 Intel의 칩셋>



- (폼팩터 다각화) 스타트업을 비롯한 후발주자들은 자사 AI반도체 및 타 기업의 프로세서를 탑재한 다양한 폼팩터를 제공하여 AI 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅 등을 지원함으로써 시장 진입

- PC 폼팩터 : 딥엑스는 자사 AI반도체를 활용하여 다양한 산업 내 기업들과 협력하여 싱글보드 컴퓨터, 기업용 PC 등 폼팩터를 제공

<딥엑스의 소형 PC 및 기업용 PC>



- AI 박스 : WinMATE, msi는 인텔 및 NVIDIA Jetson 플랫폼 등을 활용하여 AI 컴퓨팅 및 Edge AI 작업을 위한 다양한 폼팩터를 제작

<WinMATE, msi 품팩터>



<WinMATE AI 컴퓨팅 박스>



<msi 엣지 AI 박스>

④ AI PC 대중화 시대 개막 : 경량 추론용 Copilot+ PC와 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 DGX Spark

○ (AI PC) 인텔 및 AMD의 프로세서가 AI PC 내 많은 비중을 차지하고 있으나, 스냅드래곤 X 시리즈를 탑재한 AI PC의 비중 또한 증가하며 경쟁 심화

- Intel 프로세서 : msi는 인텔의 프로세서와 AI Boost NPU가 탑재되어 Copilot+ 지원으로 효율적인 AI 워크플로우를 가능하게 하는 Cubi NUC AI Series를 통해 지속 가능한 기술 특별상 수상

* 인텔의 코어 울트라 프로세서와 AI Boost 탑재

- AMD 프로세서 : AMD는 ASUS와 협력하여 AMD Ryzen AI 300 시리즈 프로세서로 구성되는 상업용 AI PC인 ASUS Expert P 시리즈 Copilot+ PC를 발표

* 노트북, 데스크톱, 올인원 PC가 포함된 시리즈

- 퀄컴 프로세서 : ASUS의 세계에서 가장 가벼운 14인치 Copilot+ PC인 스냅드래곤 X 시리즈 프로세서 기반 Zenbook A14에 대해 퀄컴의 CEO가 기조연설을 통해 소개

* Zenbook A14, Vivobook S14, Vivobook S16 모두 Copilot+ PC로 AI 생산성, 실시

간 번역 등 도구를 제공

- (NVIDIA 개인용 AI 슈퍼컴퓨터) NVIDIA는 자사 블랙웰 울트라 플랫폼을 기반으로 하여 자체 제작 및 다른 기업과 협력하여 개인용 AI 슈퍼컴퓨터를 제작
 - NVIDIA : NVIDIA는 기조연설을 통해 자사 GB 10 및 GB300으로 구동되는 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 DGX Spark와 DGX Station 소개
 - * DGX Spark는 자사 GB10 블랙웰 슈퍼칩으로 구동되는 AI 네이티브 개발자 대상 제품으로 맞춤형 클라우드 AI 개발 환경을 제공하며, 1,000 AI TOPS의 AI 성능 보유 및 2,000억 개의 매개변수를 보유한 AI 모델 사용 가능
 - * DGX Station은 자사 GB300 블랙웰 슈퍼칩이 탑재된 데스크톱 시스템으로 20 PFLOPS의 AI 성능 보유 및 약 1조 개의 파라미터 모델 작동 가능
 - ASUS : ASUS는 NVIDIA의 GB10 블랙웰 슈퍼칩을 탑재한 개인용 슈퍼컴퓨터 Ascent GX10을 공개하여 고급 AI 어플리케이션 구동
 - * 최대 1,000 TOPS의 AI 성능 보유
 - GIGABYTE : 리눅스 기반의 NVIDIA DGX Spark를 통한 맞춤형 설계 중 하나로 NVIDIA GB10 블랙웰 슈퍼칩을 탑재한 개인용 AI 슈퍼컴퓨터인 AI TOP ATOM을 통해 대규모 AI 워크로드 처리
 - * 대규모 AI 워크로드 처리, 데이터 보안 강화에 중점